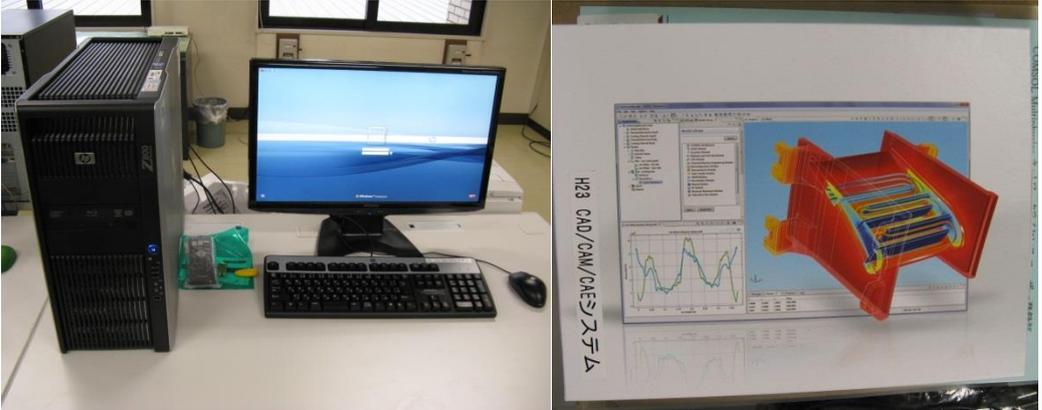


| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|--------------|----------|-----------|----|--------------|-----|-----------|
| 事業者名 | 熊本県 | | | | | | | | |
| 機器名 | CAD/CAM/CAEシステム | | | | | | | | |
| 機器写真 |  | | | | | | | | |
| 機器設置場所 | 熊本県産業技術センター | | | | | | | | |
| 機器の特徴等 | 最新機能を有したソフトウェアを備えた、コンピュータ支援による設計、加工システム、及びモデルの性能評価が可能である。 | | | | | | | | |
| 利用状況 | 年月 | 稼働 日数 | 依頼試験 依頼分析 | 技術 指導 | 試験設備貸出・利用 | | 受託研究 共同研究 | その他 | 利用 件数計 |
| | | | | | 件数 | 時間 | | | |
| | H24年1月 | | | | | | | | |
| | H24年2月 | | | | | | | | |
| | H24年3月 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| | H24年4月 | 10 | | 2 | | | 1 | 7 | 10 |
| | H24年5月 | 6 | | 1 | | | 1 | 4 | 6 |
| | H24年6月 | 8 | | | | | 2 | 6 | 8 |
| | H24年7月 | 10 | | | | | 5 | | 5 |
| | H24年8月 | 9 | | 10 | | | 8 | 2 | 20 |
| | H24年9月 | 8 | | | | | 4 | 3 | 7 |
| | H24年10月 | 12 | | 45 | | | 10 | 1 | 56 |
| | H24年11月 | 11 | | 8 | | | 8 | 2 | 18 |
| H24年12月 | 8 | | 10 | | | 5 | | 15 | |
| 利用者の声 | <ul style="list-style-type: none"> ・3D 試作モデルデータと生態モデルの確認及び構造解析に利用している。 ・構造解析用 CAD データの作成に利用している。 ・体育館内空調機能の熱流体解析による事前評価及び検証に利用している。 ・新規医療機器のデザイン検討モックアップモデルの作成に利用している。 | | | | | | | | |
| 補助事業概要 の広報資料 | http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h23/pdf/23-058koho.pdf | | | | | | | | |
| 事業者 HP | http://www.iri.pref.kumamoto.jp/ http://www.iri.pref.kumamoto.jp/support/setsubi/jisin/H23-1.pdf | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|------|--------------|----------|-----------|----|--------------|-----|-----------|
| 事業者名 | 熊本県 | | | | | | | | |
| 機器名 | TDRオシロスコープ | | | | | | | | |
| 機器写真 |  | | | | | | | | |
| 機器設置場所 | 熊本県産業技術センター | | | | | | | | |
| 機器の特徴等 | 電子回路・電気信号伝送性能を測定し、半導体・液晶の検査・製造装置の装置部品における高速デジタル信号伝送の不具合情報を得ることが出来る。 | | | | | | | | |
| 利用状況 | 年月 | 稼働日数 | 依頼試験 依頼分析 | 技術 指導 | 試験設備貸出・利用 | | 受託研究 共同研究 | その他 | 利用 件数計 |
| | H24年1月 | 5 | | | 3 | 8 | | | 3 |
| | H24年2月 | 4 | | | 1 | 2 | | | 1 |
| | H24年3月 | 7 | | | 5 | 11 | | | 5 |
| | H24年4月 | 4 | | 1 | 2 | 6 | | | 3 |
| | H24年5月 | 5 | | 2 | 2 | 8 | | | 4 |
| | H24年6月 | 9 | | 5 | 1 | 25 | | | 6 |
| | H24年7月 | 5 | | 1 | 4 | 17 | | | 5 |
| | H24年8月 | 7 | | | 5 | 14 | | | 5 |
| | H24年9月 | 3 | | | 3 | 5 | | | 3 |
| | H24年10月 | | | | | | | | |
| | H24年11月 | 3 | | 1 | 3 | 5 | | | 4 |
| H24年12月 | 3 | | | 3 | 7 | | | 3 | |
| 利用者の声 | <ul style="list-style-type: none"> ・半導体検査治具(プローブピン)測定用の校正基板の測定に利用している。 ・半導体検査用基板の特性インピーダンス測定に利用している。 ・半導体検査用基板の電極間インピーダンス測定に利用している。 | | | | | | | | |
| 補助事業概要の広報資料 | http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h23/pdf/23-058koho.pdf | | | | | | | | |
| 事業者 HP | http://www.iri.pref.kumamoto.jp/ http://www.iri.pref.kumamoto.jp/support/setsubi/jisin/H23-2.pdf | | | | | | | | |